组织芯片制作流程

1. HE染色切片病理诊断，并标记目标组织的范围。
2. 按照实验目的设计组织芯片阵列的组织类型和排列方式。
3. 用组织包埋机制备合适的空白受体蜡块。
4. 用组织阵列仪按照阵列设计抽提病理蜡块组织芯并有规律的排列在空白受体蜡块上。
5. 组织阵列块在52℃恒温烤箱中加热融合，使组织芯与受体蜡块紧密相连。
6. 用半自动组织切片机以20微米/转的进刀速度对组织阵列块进行修整蜡块，直至80%的组织芯完全曝露。
7. 用半自动组织切片机以4微米/转的进刀速度对组织阵列块进行切片，切片裱附在防脱片处理的进口载玻片上。
8. 阵列切片置于60 ℃恒温烤箱中烤片16个小时。
9. 组织芯片实验白片保存在切片盒中，置于冰箱4 ℃保存。

